

Phoenix V|tome|x M Neo

PHOENIX V|tome|x M Neo

全新旗舰工业CT 带来全能质量
控制解决方案

最全能的微米/纳米双焦点# 工业 CT 扫描方案

全新的 Phoenix V|tome|x M Neo, 探索无损检测的未来。

Waygate 旗舰型工业 CT 解决方案在检测样品灵活性、检测效率和检测质量方面树立了新的行业标杆, 使其成为各行各业最广泛应用的不二之选。

可调节焦点到探测器 (FDD) 距离, 缩短扫描时间的同时提高扫描质量。

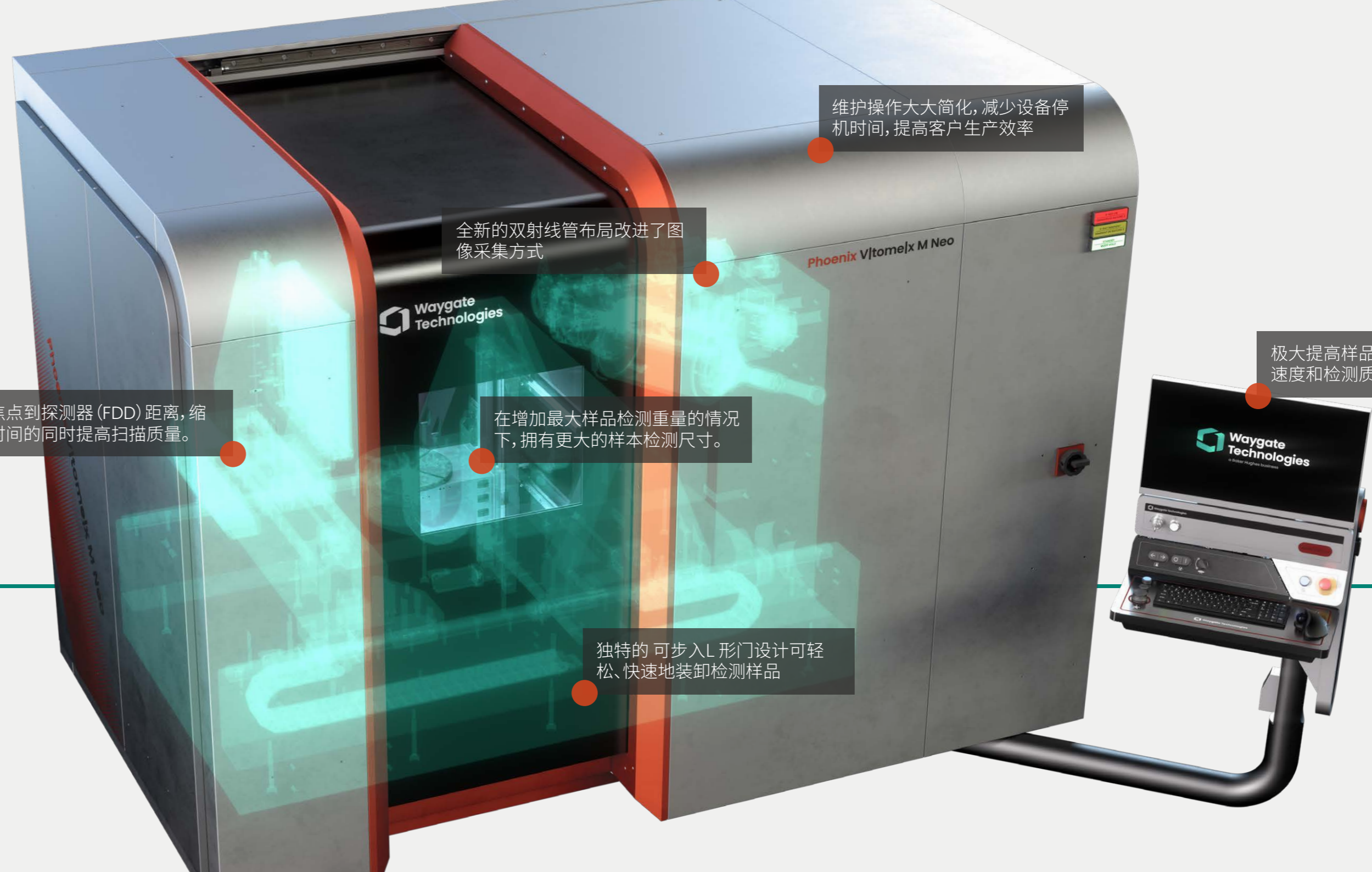
全新的双射线管布局改进了图像采集方式

维护操作大大简化, 减少设备停机时间, 提高客户生产效率

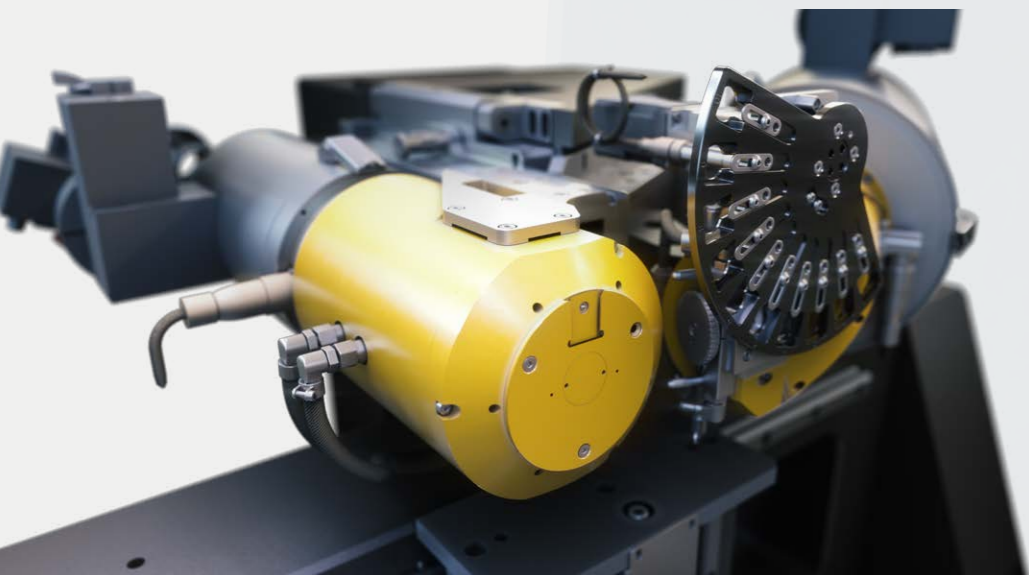
在增加最大样品检测重量的情况下, 拥有更大的样本检测尺寸。

独特的可步入 L 形门设计可轻松、快速地装卸检测样品

极大提高样品适用范围、检测速度和检测质量

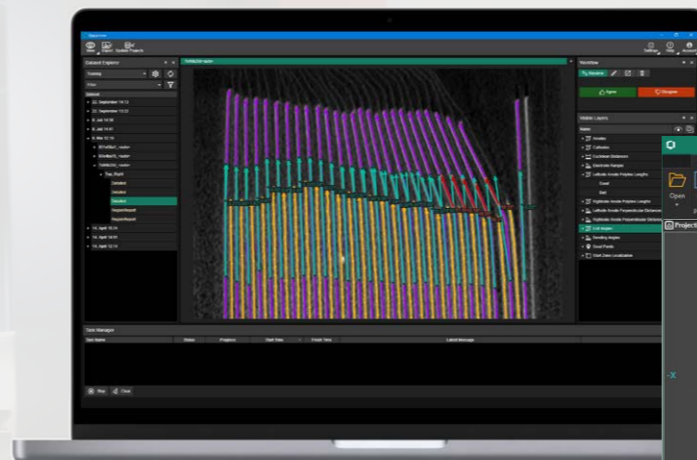


方案亮点

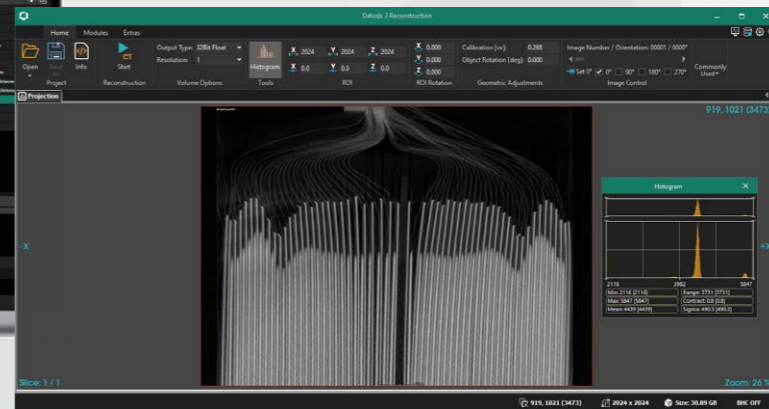


先进的功能可实现无与伦比的扫描图像和全面的失效分析

- 高性能微米和纳米焦点双管解决方案
- 水平方向的双导管设置改进了图像采集方式
- 独有的 Dynamic 4I 高性能探测器
- 高通量靶技术可极大提升扫描速度



Xlaprover



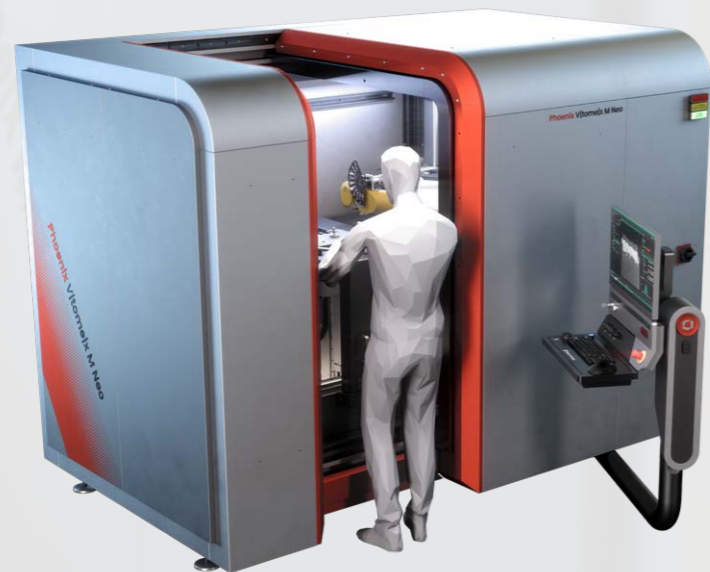
Datas|x

高自动化方案提升设备使用效率

- 通过 Xlaprover 软件实现自动
- 缺陷识别 (ADR) 解决方案
- 配备最新的 Datas|x 软件, 可全面控制数据采集, 加快数据重建速度

无障碍样品装卸设计

- 操作人员可通过两扇大滑动轻松装卸样品
- 通过设备内部/外部吊装装置灵活装卸
- 多功能控制面板

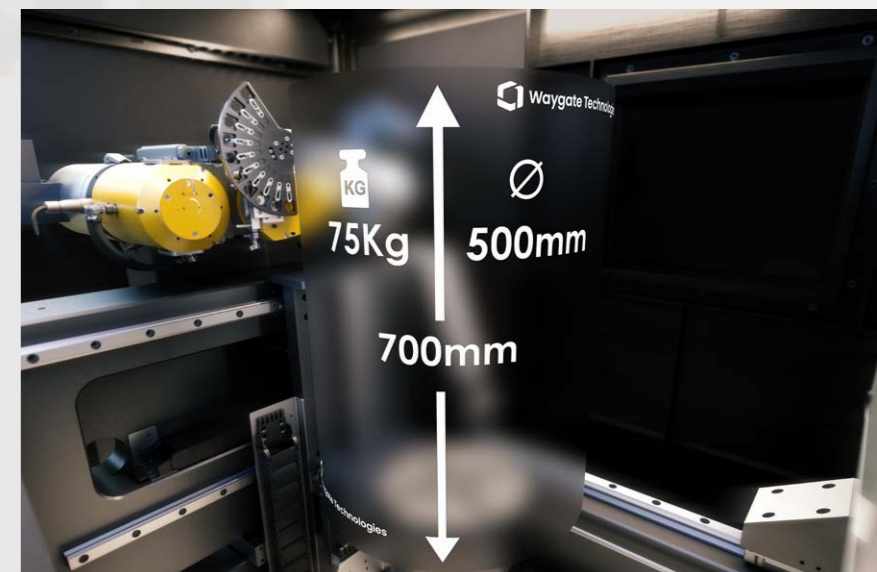


易于维护的解决方案

- 易于进入的维护门
- 重新设计的机械平台可实现高效维护

增大扫描区域, 适用于较大和较重的样品

- 增大扫描区域, 同时适用于检测小型和大型样品
- 可变焦点到探测器距离 (FDD) 设计

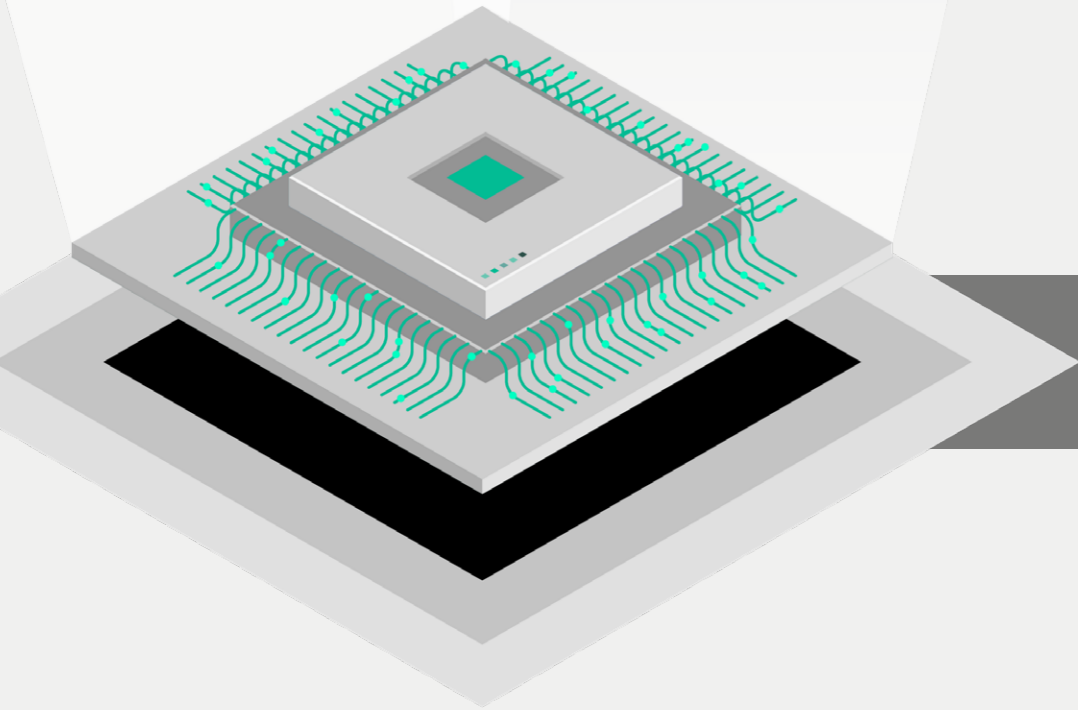


应用领域

专为应对行业挑战而设计

Phoenix V|tome|x M Neo 是全能型的工业CT扫描系统, 适用于实验室环境中的各种 3D 测量、研究和评估应用。

此外, 它的自动化功能使其非常适合在生产环境中进行精确测试, 为工业应用提供可靠的结果。

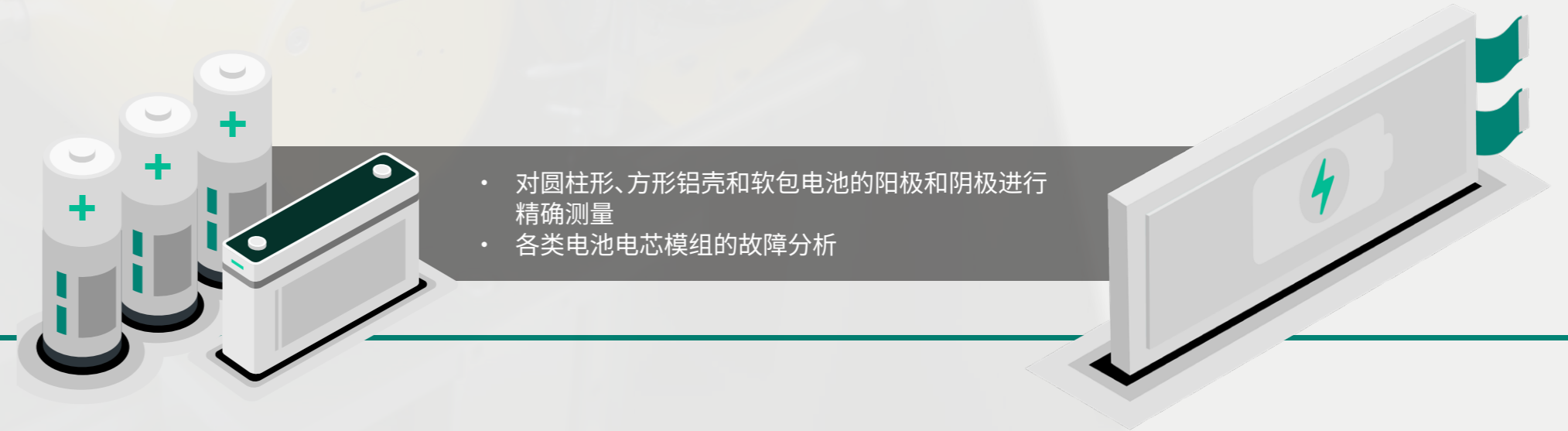


- 是评估微观结构和复杂装配、检查焊点或检测小型和大型电路板的理想之选
- 帮助优化电子行业客户的生产流程

- 擅长航空行业关键部件检测, 如用于复合材料, 叶片和增材制造部件, 以及尖端碳纤维技术
- 评估卫星专用复杂电子元件的先进能力



- 对圆柱形、方形铝壳和软包电池的阳极和阴极进行精确测量
- 各类电池电芯模组的故障分析

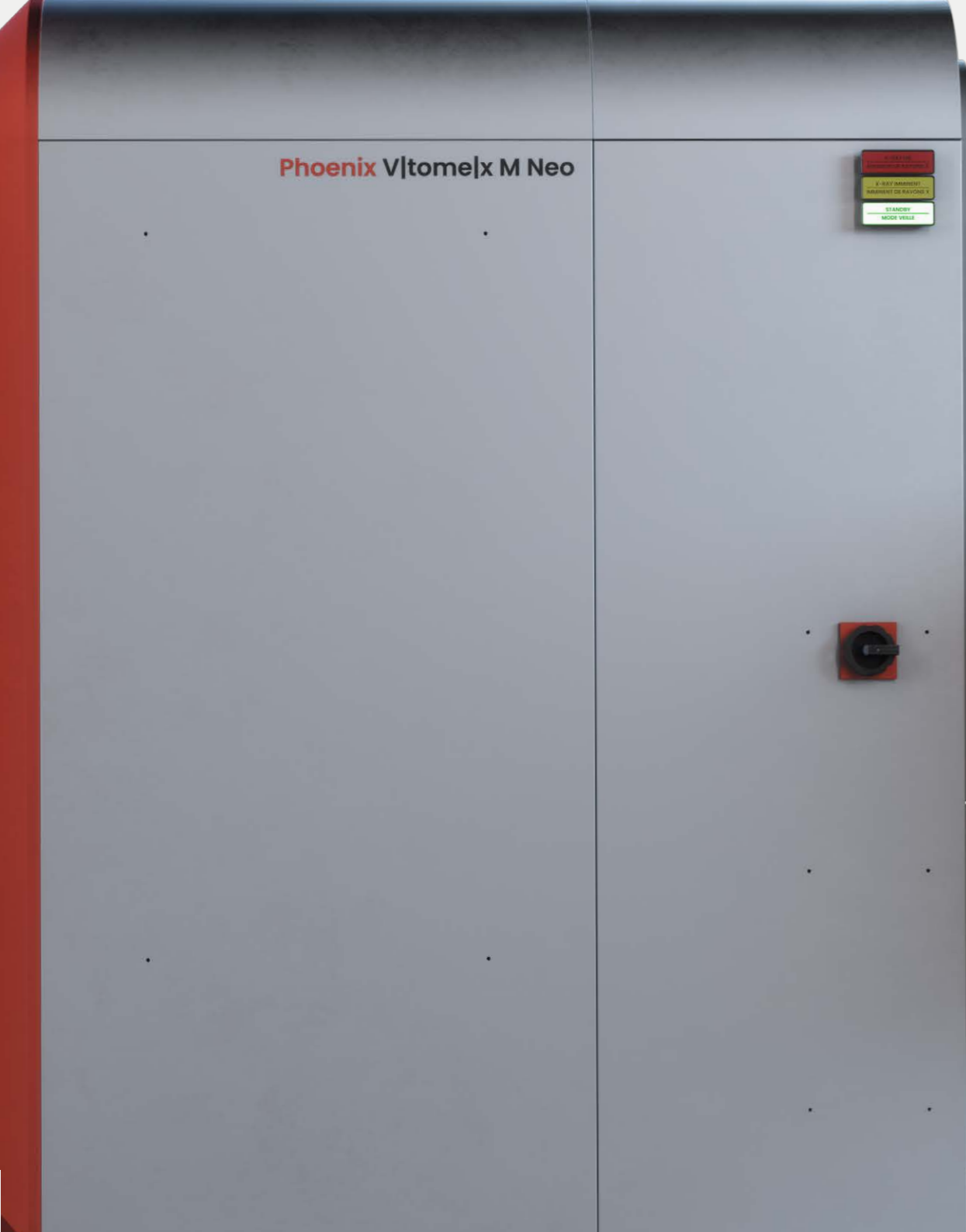


悠久的历史

青处于蓝

Phoenix V^otome[®]x M Neo 是新一代工业 CT 系统,它建立在广受好评的 Phoenix V^otome[®]x 平台的基础上,后者全球装机量已超过一千台。设备领跑工业 CT 检测行业,提供最佳的图像效果、更大的扫描区域(适用于

更大、更重的样品检测承重)、可变的焦点到探测器距离(FDD)以及全新的机柜设计,从而提高了样品检测灵活性和进入维护的便捷性。



50 KG V|tome|x M

75 KG V|tome|x M Neo

增加最大样品重量

独特的 L 形门可装载
重型和大型样品

420 x 400mm

V|tome|x M

增加最大扫描尺寸

500 x 700mm

V|tome|x M Neo



X 射线管	开放式定向高功率微焦点 X 射线管, 封闭式冷却水回路 可选配额外的开放式大功率纳米焦点透射 X 射线管
最大电压/功率	300 kV / 500 W, 也可选配 240 kV / 320 W 微焦点 X 射线管 用于 nanoCT® 的双射线管选项: 附加 180 kV / 20 W 高功率纳米聚焦管, 配备钻石靶 Diamond window、高精度旋转装置, 只需按下按钮即可轻松更换射线管
几何放大倍率 (3D)	1.29 x 至 100 x; 使用纳米焦点 X 射线管时可放大至 225 x
细节检测能力	低至 < 1 μm (微米焦点 X 射线管); 可选低至 0.2 μm (纳米焦点 X 射线管)
最小体素尺寸	小至 2 μm (微聚点), 可选 1 μm (Dynamic 4I 100); 可选小至 <0.5 μm (纳米焦点 + Dynamic 4I 100)
探测器类型 (全部符合美国 ASTM E2597 标准)	温度稳定的 Dynamic 4I 200 大尺寸探测器, 具有卓越的图像和扫描图像质量, 410 x 410 毫米 (16 英寸 x 16 英寸), 200 μm 像素尺寸, 2036 x 2036 像素 (4 MP), 超高动态范围 > 10000:1 可选 Dynamic 4I 100 探测器, 410 x 410 毫米 (16 英寸 x 16 英寸), 100 μm 像素尺寸, 4048 x 4048 像素 (16MP), CT 分辨率翻倍
机械运动平台	基于大理石平台的高精度 6 轴机械平台
焦点到探测器距离 (FDD)	310 毫米 - 900 毫米 (12.2 英寸 - 35.4 英寸)
最大样品检测直径 x 高度	310 毫米 x 700 毫米 (12.2 英寸 x 27.5 英寸); 使用偏移扫描时, 直径最大可达 500 毫米 (19.7 英寸)
最大样品重量	75 千克 (165 磅), 高精度 CT
最大对焦点到样品距离	700 毫米 (27.55 英寸), 适用于微焦点管
系统尺寸 宽 x 高 x 深	约 2,911 毫米 x 2,177 毫米 x 1,710 毫米 (114.6 英寸 x 85.7 英寸 x 67.3 英寸)
系统重量	约 9,500 千克 (20,940 磅)
温度稳定	主动 X 射线管冷却 温度控制柜 温度稳定探测器
选配专利 Scatter Correct 散射矫正技术	与扇束 CT 相同的 CT 质量, 散射辐射伪影最小。 最大扫描直径: 290 毫米, 使用偏移扫描时最大可达 450 毫米
选配高通量靶	CT 扫描速度提高 2 倍或分辨率提高 2 倍; 最大 X 射线检测功率高达 100 W
可选 Helix CT 螺旋扫描功能和 Offset CT 偏置扫描功能	先进的扫描方式, 提高扫描速度和数据质量: Helix CT 用于长工件扫描, 可减少伪影并提高扫描质量; Offset CT 用于扫描更大的工件或相同尺寸但分辨率更高的应用
选配 Click&measure CT 一键测量功能	可配置
软件	Phoenix Datas x 3D 计算机断层扫描采集和重建软件 根据要求提供用于 3D 测量、故障或结构分析的各种 3D 评估软件包
辐射防护	根据德国 StrSchG/StrSchV 标准, 辐射安全柜用于完全防护安装, 无需型号认证 符合法国 NFC 74 100 和美国 21 CFR Subchapter J 性能标准

联系我们讨论您的检测需求

waygate-tech.com

版权所有 2024 Baker Hughes Company。保留所有权利。
BHFF60028 (05/2024)